2026年11月25日

各　位

会社名　　株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル
代表者名　　代表取締役会長兼社長ＣＥＯ　山本 達夫
（コード番号３６５２、東証グロース）
問合せ先　　執行役員 管理統括本部長 吉田 幹夫
ＴＥＬ　　０３－６４５４－０４５０

2027年３月期第２四半期決算説明会書き起こしのお知らせ

2026年11月12日に開催しました「2027年３月期第２四半期決算説明会」の書き起こしを公開しましたので、お知らせします。2027年３月期第２四半期決算概要、2027年３月期通期業績予想、成長戦略・ビジョン等についてご説明していますので、ご参照ください。なお、掲載にあたっては、読みやすさを考慮して一部表現を編集しています。

【2027年３月期第２四半期　決算説明会概要】
日時：2026年11月12日　16:30～17:30
説明者：代表取締役会長兼社長ＣＥＯ　山本 達夫
執行役員 管理統括本部長 吉田 幹夫

MAKING THE IMAGE INTELLIGENT



管理統括本部長の吉田です。本日は当社の決算説明会にご参加いただきありがとうございます。

1 2027年3月期 第2四半期 決算説明

2 2027年3月期 通期業績予想

3 成長戦略・ビジョン

Copyright (C) Digital Media Professionals Inc. All Rights Reserved.

本日のアジェンダですが、2027 年 3 月期第 2 四半期決算と 2027 年 3 月期通期業績予想について私から説明し、その後、成長戦略・ビジョンについて山本が説明します。

1 2027年3月期 第2四半期 決算説明

2 2027年3月期 通期業績予想

3 成長戦略・ビジョン

Copyright (C) Digital Media Professionals Inc. All Rights Reserved.

会社概要

世界有数のグラフィックスIPベンダーとしての創業以来の経験・知見を活かし、近年は**アルゴリズム・ソフトウエアからハードウエア**、並びに**エッジからクラウド**に亘る一貫したAIサービスの提供により、お客様や社会の課題解決に貢献しています

会社名	株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル（DMP）
設立	2002年7月 （2011年6月東証マザーズ上場，2022年4月東証グロース移行）
所在地	東京都中野区
代表者	代表取締役会長兼社長CEO 山本 達夫
資本金	1,838百万円
従業員数	50名（2026年4月1日現在）
特許数	36件

IPコアライセンス事業

・AI/GPU IPコアライセンス
・AIソフトウエアライセンス



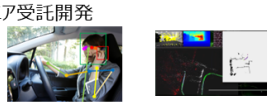
製品事業

・アミューズメント市場向け画像処理半導体
・エッジAI半導体
・協働ロボット向けビジョンシステム
・FA製品（AMR本体/コンポーネント）
・モジュール



プロフェッショナルサービス事業

・AIアルゴリズム、コンピュータビジョンソフトウエア受託開発
・FPGA/ボード受託開発
・ロボティクス・セーフティに係る顧客製品・サービス開発サポート



Copyright (C) Digital Media Professionals Inc. All Rights Reserved.

まず、決算内容のご説明の前に、当社について簡単にご紹介します。当社は 2002 年 7 月に大学発のベンチャー企業として発足以来、グラフィックス技術を核に事業を行ってきました。GPU IP が任天堂のゲーム機に採用され、アミューズメント市場向けに投入した統合グラフィックス LSI は現在の収益の柱となっています。近年は GPU と親和性の高い AI・ディープラーニング領域に進出し、アルゴリズム、ソフトウェアからハードウェア、並びにエッジからクラウドにわたる一貫した開発体制、製品・サービスを提供できることを強みとして、DMP ならではの技術・製品・サービスでお客様の課題や社会課題の解決に貢献しています。

2027年3月期 第2四半期 - 業績ハイライト

- 成長分野への経営資源の集中を継続し、Physical AIの社会実装に向けた基盤づくりを推進
- 鉄道・物流向け受託開発やFA製品の拡大により、ロボティクス・セーフティ分野が確実に成長（YoY +35%）
- アミューズメント分野は「RS1」の量産出荷を継続、保通協等の検定試験適合率の改善の動きは弱い

全社	事業別売上高	分野別売上高
売上高	IPコアライセンス	ロボティクス・セーフティ
899百万円	**43**百万円	**159**百万円
(YoY △0.4%)	(YoY △22%)	(YoY +35%)
経常利益	製品	アミューズメント
△207百万円	**773**百万円	**702**百万円
（前年同期 △292百万円 ）	(YoY △7%)	(YoY △5%)
	プロフェッショナルサービス	その他
	81百万円	**36**百万円
	(YoY +319%)	(YoY △16%)

※ YoY (Year on Year)：前年同期の連結ベース決算数値との比較

Copyright (C) Digital Media Professionals Inc. All Rights Reserved.

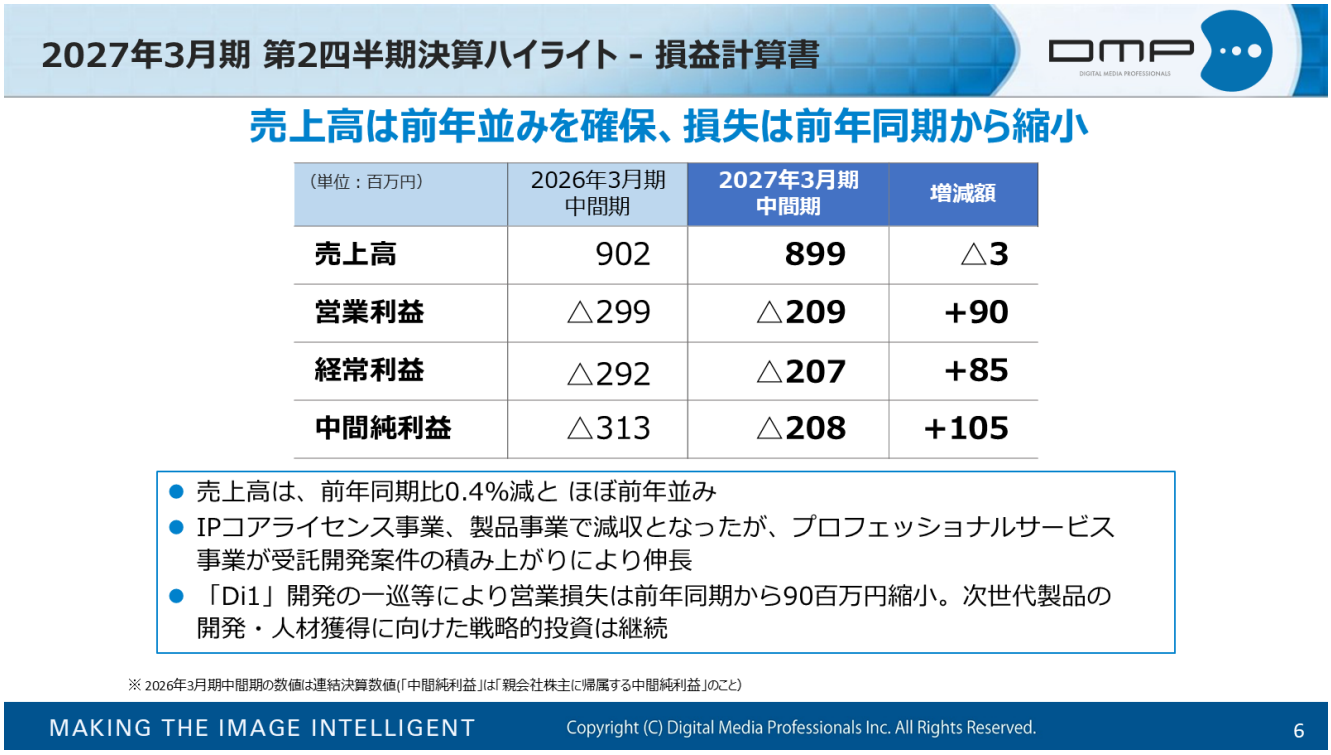
それでは、2027 年 3 月期第 2 四半期（中間期）のハイライトからお話しします。

当社では、成長分野への経営資源の集中を継続し、フィジカル AI の社会実装に向けた基盤づくりを推進しています。この中間期では、エッジ AI 半導体 Di1 の開発が一巡し、国内外のパートナー企業との実装・

検証を通じたエコシステムの構築に軸足を移すとともに、次世代製品の企画、開発・検証基盤の整備、および開発・販売体制の増強に向けた人材の採用を進めました。

インドの Sparsh CCTV 社や ideaForge 社など、国内外の複数の顧客において Di1 搭載製品の開発が進んでいます。Di1 関連である鉄道・物流向けプロフェッショナルサービスの受託案件や、昨年立ち上げた FA 製品の販売事業の売上の拡大もあり、ロボティクス・セーフティ分野を確実に成長させることができました。

一方で、アミューズメント分野とその他分野については、前年同期比で減収となりました。主力製品 RS1 の量産出荷を継続していますが、保通協の検定適合率の改善の動きは弱く、アミューズメント分野の減収の要因となりました。製品事業についても、アミューズメント分野の減収に加え、前年同期にあった大型案件の反動もあり、前年同期を下回りました。IP コアライセンス事業は、メモリー価格の高騰などによるデジタルカメラ・プリンター等の出荷減少により、ロイヤリティ収入が減少しました。



以上の結果、当中間会計期間の売上高は前年並みの 8 億 9900 万円となりました。

損益面では、事業拡大を見据えた積極的な人材採用の推進により労務費および採用手数料が増加したことに加え、研究開発費 9500 万円を計上したことから、販売費および一般管理費を吸収できず、営業損失は 2 億 900 万円、経常損失は 2 億 700 万円、中間純損失は 2 億 800 万円となりました。

2027年3月期 第2四半期決算ハイライト - 事業／分野別売上高

●事業別売上高

IPコアライセンス事業 **43百万円** 前年同期 55百万円

●主にデジタルカメラ・プリンター等のデジタル機器向けAI/GPUランニングロイヤリティ、ロボティクス・セーフティ分野におけるリカーリング収益、メンテナンスサポート収入等を計上

製品事業 **773百万円** 前年同期 827百万円

●RS1の量産出荷、Cambrianビジョンシステム、FA製品、「Di1」開発キット等の売上を計上

ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙｻｰﾋﾞｽ事業 **81百万円** 前年同期 19百万円

●半導体製造装置向け、安全用途向け、物流機器向け等の受託開発に加え、Cambrianビジョンシステムの学習支援等の売上を計上

●分野別売上高

ロボティクス・セーフティ分野 **159百万円** 前年同期 118百万円
売上構成比(前年同期比) 17.7% (+4.6pt)

●受託開発サービス、FA製品・Cambrianビジョンシステム・「Di1」開発キット等の製品売上、リカーリング収益等の売上を計上

アミューズメント分野 **702百万円** 前年同期 740百万円
売上構成比(前年同期比) 78.2% (△3.9pt)

●主にRS1の量産出荷売上を計上

その他分野 **36百万円** 前年同期 43百万円
売上構成比(前年同期比) 4.1% (△0.8pt)

●デジタル機器向けAI/GPU IPランニングロイヤリティ、メンテナンスサポート収入等を計上

※前年同期の売上金額は連結ベース決算数値

Copyright (C) Digital Media Professionals Inc. All Rights Reserved.

こちらのページでは事業別・分野別の売上高を記載しています。説明の内容は先ほどと重なりますので割愛させていただきます。記載内容をご確認いただければと思います。

2027年3月期 第2四半期決算ハイライト - 貸借対照表

自己資本比率は90.6%と高水準を維持
～戦略的投資を可能にする強固な財務体質～

（単位：百万円）	2026年3月末	2026年9月末	増減額	主な増減要因
流動資産	2,790	2,219	△571	現金及び預金 △606 原材料及び貯蔵品△79 売掛金及び契約資産 △12 有価証券 +188
固定資産	1,041	1,155	+114	有形固定資産(工具器具備品) +49 投資有価証券 +31
資産合計	**3,831**	**3,374**	**△456**	
流動負債	537	289	△248	買掛金 △291
固定負債	27	27	△0	
負債合計	564	316	△248	
純資産合計	**3,266**	**3,058**	**△208**	利益剰余金 △208
負債・純資産合計	**3,831**	**3,374**	**△456**	

Copyright (C) Digital Media Professionals Inc. All Rights Reserved.

続いて貸借対照表です。流動資産は 22 億 1900 万円となり、前事業年度末に比べ 5 億 7100 万円減少しました。これは主に、商流の変更に伴い一時的に買掛金の支払いが先行したこと、および有価証券を 1 億 8800 万円購入したことにより現金及び預金が 6 億 600 万円減少したこと、原材料及び貯蔵品が 7900 万円減少したことによるものです。固定資産は 11 億 5500 万円となり、前事業年度末に比べ 1 億 1400 万円増加しました。これは有形固定資産が 4900 万円、投資有価証券が 3100 万円増加したことによるものです。

負債は、流動負債と固定負債の合計で 3 億 1600 万円となりました。主に買掛金が 2 億 9100 万円減

少したことにより、前事業年度末に比べ 2 億 4800 万円減少しています。
純資産は、中間純損失の計上により利益剰余金が 2 億 800 万円減少したため、30 億 5800 万円となりました。これらの結果、自己資本比率は 90.6%となっています。

1 2027年3月期 第2四半期 決算説明

2 2027年3月期 通期業績予想

3 成長戦略・ビジョン

Copyright (C) Digital Media Professionals Inc. All Rights Reserved.

2027 年 3 月期の業績予想について説明します。

2027年3月期 通期業績予想

5月15日公表の通期業績予想に変更なし
～2027年3月期は将来の成長に向けた攻めの戦略的投資を実行～

(単位：百万円)	2026年3月期 通期実績	2027年3月期 通期予想	2027年3月期 増減
売上高	2,432	**3,640**	+1,207(+49.6%)
営業利益	△311	**30**	+341
経常利益	△293	**45**	+338
当期純利益	△327	**30**	+357

- エッジAI半導体「Di1」事業の立ち上がりや、アミューズメント分野の周辺ビジネスの取り込み等により業績は下期に偏重の見込
- 安定収益基盤であるアミューズメント分野での着実な収益の確保を図るとともに、成長領域であるエッジAI半導体事業およびロボティクス・セーフティ分野の拡大に取り組む。エッジAI半導体 Di1の量産案件の積み上げおよび製品ミックスの改善による収益・利益の改善に取り組むと同時に、中長期的成長に向けた研究開発や必要人材の積極採用を含む戦略的投資を引き続き推進

Copyright (C) Digital Media Professionals Inc. All Rights Reserved.

業績予想については、5 月 15 日に公表した通期業績予想を据え置いています。
第 2 四半期までの累計の売上高は 8 億 9900 万円で、通期の売上高予想 36 億 4000 万円に対する進捗率は 24.7%にとどまりますが、エッジ AI 半導体 Di1 事業の立ち上がりやアミューズメント分野の周辺ビジネスの取り込みを計画しており、業績は下期に偏重する見込みです。

当社は、アミューズメント分野で着実な収益の確保を図るとともに、成長領域であるエッジ AI 半導体事業およびロボティクス・セーフティ分野の拡大に取り組んでまいります。量産案件の積み上げおよび製品ミックスの改善による収益・利益の改善に取り組むと同時に、中長期的な成長に向けた戦略的な投資を引き続き推進してまいります。
私からのご説明は以上です。



1 2027年3月期 第2四半期 決算説明

2 2027年3月期 通期業績予想

3 **成長戦略・ビジョン**

Copyright (C) Digital Media Professionals Inc. All Rights Reserved.

続きまして、山本から成長戦略・ビジョンについてお話しします。



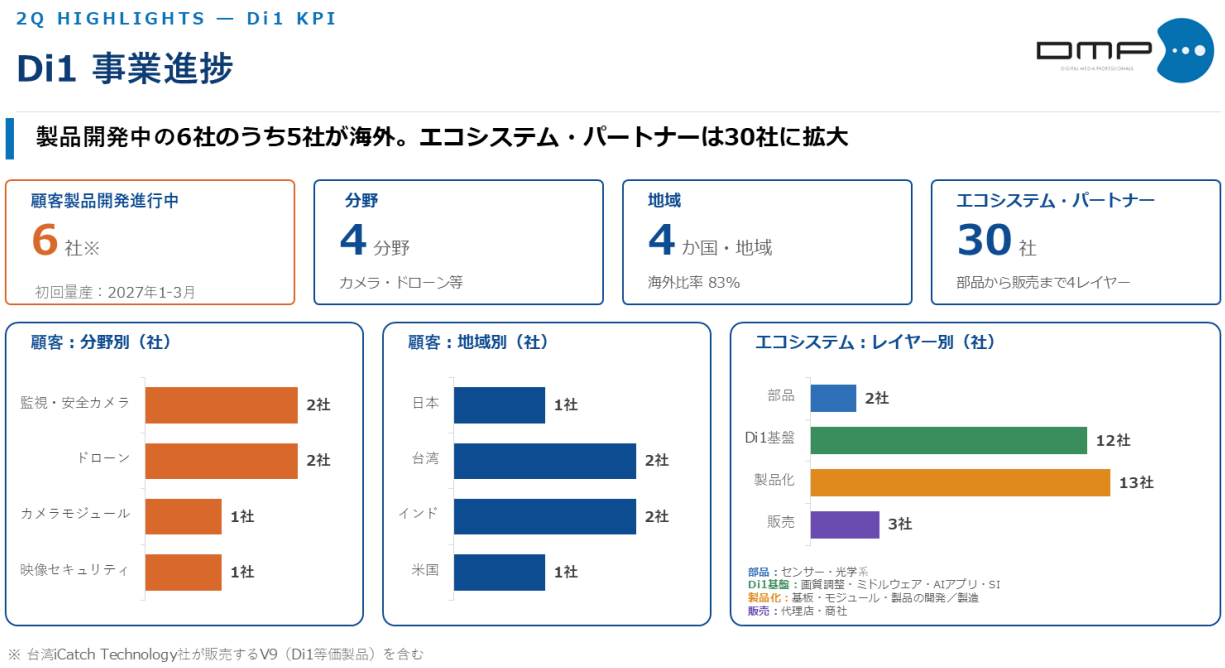
Copyright (C) Digital Media Professionals Inc. All Rights Reserved.

まず、第 2 四半期のハイライトですが、3 つの重点領域すべてで、エッジ AI の社会実装が前進しています。

１つ目は社会課題の解決です。当社は画像インテリジェンスの力で社会課題を解決することをパーパスとしており、特に安心・安全な社会をつくることに関して今期は成果がありました。１つは、JR 東海様の東海道新幹線のホームに Di1 搭載 AI カメラを設置し、安全確認を支援する取り組みです。もう１つは、昨年から取り組んでいる西尾レントオール様とのスケートボード滑走の検知システムで、こちらも精度を含めて進展しています。それぞれ後ほど詳しくご説明します。

２つ目はフィジカル AI の実装です。当社のフィジカル AI の実装拠点として、東京流通センター内の東京ロボティクス・イノベーションセンター（TRIC）が７月に開所し、稼働しています。また、当社の半導体 Di1 と、AMR 等の FA 事業において、エコシステムの構築が進んでいます。

３つ目は、新たな重点領域と考えているデュアルユース、すなわち民生と防衛の両分野に向けた技術・製品のビジネスです。ここではインドの世界第３位のデュアルユースのドローンメーカーである ideaForge 社との提携が進んでいます。また、10 月には ideaForge 社と Sparsh CCTV 社を招いて日本でフィジカル AI セミナーを開催するとともに、ideaForge 社の来日にあわせて、防衛省をはじめ防衛産業・デュアルユース分野の関係者の方々との関係を築くことができました。



それぞれの分野についてお話しする前に、Di1 の事業進捗についてお話しします。

現在、Di1 を使った、量産を前提としたお客様での製品開発が 6 社で進んでいます。そのうち早いお客様では、来年 2027 年の 1 月から 3 月の間に量産が始まる見込みです。内訳を見ますと、分野は監視カメラ、ドローン、カメラモジュール、映像セキュリティなどで、地域は日本、台湾、インド、米国のお客様で製品開発が進んでおり、比率では海外が 80%を超えて先行しています。国内でも数社のお客様で評価が進んでおり、今後、量産を前提とした製品開発に進むと考えています。

また、Di1 を販売していくうえで非常に重要なパートナー・エコシステムの構築についても、ここに記載の 4 つのレイヤー、すなわち部品（センサー等）、Di1 基盤（ソフトウェアや AI モデルなど主にソフトウェアの分野）、製品化（ボードやシステムの開発）、販売において、現在 30 社ほどのパートナーと協業しており、今後さらにパートナーの数を増やしていきたいと考えています。

01 社会課題の解決 — 安心・安全

JR東海：東海道新幹線ホームの安全性向上の検証

Di1搭載AIカメラを提供 — 鉄道インフラへのエッジAI実装の第一歩



DMPの役割・技術

- Di1搭載AIカメラを開発し提供
- ソフトウェアとAIモデルを開発し提供

Di1の高い処理能力とシステム小型化により、
設置コストの大幅削減を実現



AIカメラ　コントローラ

（設置駅）　新大阪　京都　三河安城　新横浜　東京

検証の内容

- ホーム上の乗降口付近にDi1搭載AIカメラを設置し、
  動画から人物の位置データを抽出
- 乗客が可動柵と列車の間に取り残されていないかを検知

今後の展開

- AIカメラによる安全確認支援技術をさらに高度化
- 鉄道各社をはじめとする社会インフラへの
  エッジAI実装を推進

Copyright (C) Digital Media Professionals Inc. All Rights Reserved.

JR 東海様の案件についてお話しします。現在、新大阪、京都、三河安城、新横浜、東京の各駅に、Di1を使ったカメラシステムが設置されています。これは、当社が開発した Di1 搭載のカメラモジュールとコントローラをホームの乗降口付近に設置し、可動柵と列車の間に子どもや荷物が取り残されていないかを検知してアラームを上げるシステムです。

こちらは期待以上の結果を出しており、特に Di1 の高い処理能力とシステムの小型化により、従来のシステムに比べて設置コストおよびスペースの大幅な削減を実現できています。今後の展開としては、この安全確認支援技術をさらに高度化するとともに、鉄道各社をはじめとする社会インフラへの AI の実装を推進していく予定です。

01 社会課題の解決 — 安心・安全

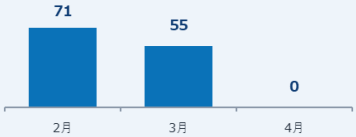
西尾レントオールとの協業：LLM異常行動検知の実証

グラングリーン大阪で実運用 — LLM×ビジョンAIで迷惑行為の検知精度を2倍に向上



認識精度
41.8% →
83.5%
約2倍に向上

スケートボード滑走の検知件数(件/月)
抑止効果により大幅減少



実証の概要

場所	グラングリーン大阪の一部エリア
期間	2026年1月 ～ 継続実施中
テーマ	スケートボード滑走の検知・抑止
役割	西尾レントオール：実証主体・現地運用 DMP：検知システムの開発・チューニング

Vision-LLM Insight の強み

- ✓ LLM×ビジョンAIで
  行動の意味・文脈を解釈
- ✓ 実運用データで反復チューニング
- ✓ 既設IPカメラをそのまま活用、
  大きな設備投資が不要

今後の展開

侵入・放置・不審な徘徊・転倒などへシナリオを拡大し、

自治体・施設・建設・物流現場への社会実装を加速

Copyright (C) Digital Media Professionals Inc. All Rights Reserved.

次に、2025 年から取り組んでいる西尾レントオール様とのスケートボード滑走の検知システムです。昨年に引き続き、今年はグラングリーン大阪で実証実験を続け、現在は実運用に至っています。
ここでは当社の Vision-LLM Insight というソフトウェアをベースにしたシステムを使い、認識の精度が大幅に向上しています。83.5%と、昨年に比べて約 2 倍に向上しました。また、このシステムの抑止効果によって、実際のスケートボード滑走の検知件数が 71 件から 0 件へ大幅に減少するという非常に大きな効果を上げています。
今後の展開としては、自治体、施設、建設、物流現場などにおいて、侵入や放置、転倒といったシナリオに広げることで、安心・安全な社会づくりに貢献していきたいと考えています。

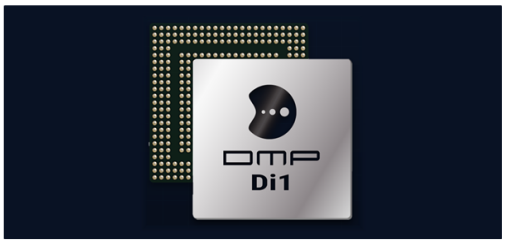


MAKING THE IMAGE INTELLIGENT Copyright (C) Digital Media Professionals Inc. All Rights Reserved. 16

それでは、フィジカル AI のお話をさせていただきます。フィジカル AI に求められるのは、その場で見て、理解する力です。これをクラウドではなくエッジで完結させるということです。
カメラを使った認識、そのカメラの画像から抽出した意味の理解、それに基づいて様々な基準や優先順位などから判断を行い、それによって行動する、つまりロボットを動かすといったことをエッジデバイスの中で完結させていきます。これをデバイス上でミリ秒単位で完結させる必要があるため、クラウドではなくエッジが鍵になってきます。

02 Physical AIの実装

DMPの答え：Physical AIのためのエッジAI半導体「Di1」



DMP Di1

- 世界初※のFP4対応エッジNPUで高効率を実現
- 4チャンネル・ステレオビジョンで高精度な3D認識
- 低消費電力・低発熱・低システムコストを追求した設計

※2025年時点、DMP調べ


セキュリティ・監視


ドローン


AMR・ロボティクス


モビリティ

Copyright (C) Digital Media Professionals Inc. All Rights Reserved.

このフィジカル AI に対する DMP の答えが、エッジ AI 半導体 Di1 です。

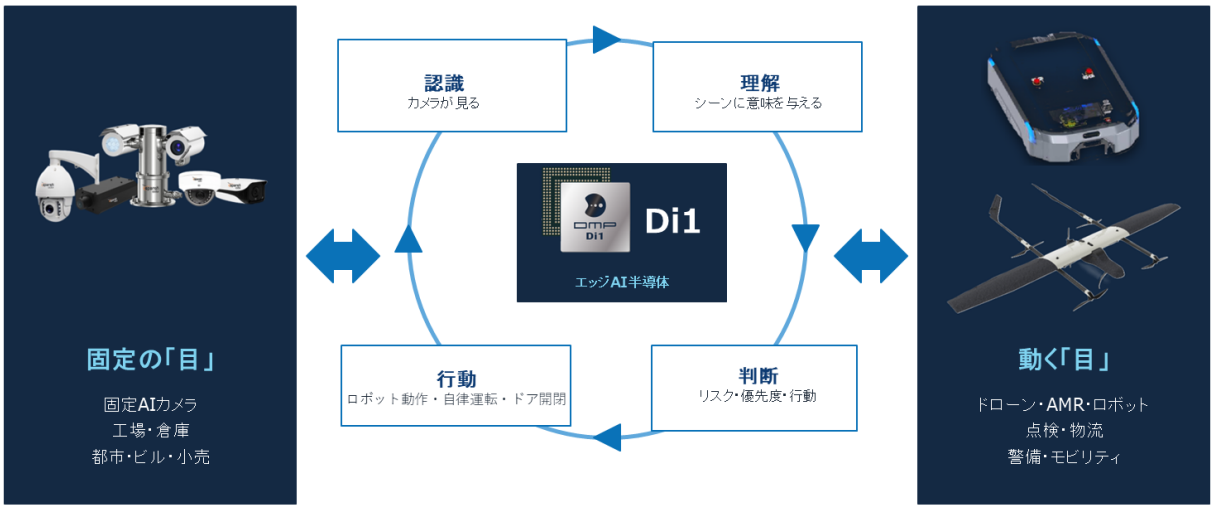
Di1 は世界で初めて（当社調べ）FP4、浮動小数点 4 ビットという演算方式をエッジ側で採用し、非常に効率のよい AI 処理を実現しています。例えば JR 東海様の案件でも FP4 が非常に効果を発揮し、小型・軽量で非常に精度の高いシステムが完成しています。

また、4 チャンネルのステレオビジョンにより、360 度の空間で非常に高精度な 3D の認識ができます。こちらは特にドローンのお客様から評価されており、Di1 をドローンに採用するドローンメーカーさんもいらっしゃる状況です。

全般として、低消費電力、それによる発熱の低減、そしてシステムコストの低減が、高性能で小型なエッジ AI デバイスをつくることに貢献しています。さらに、ドローン等では電力や性能に加えて重量も非常に重要な観点になりますので、そうした点でも Di1 は非常に高く評価されています。

02 Physical AIの実装

目・頭脳・身体 ― そしてそれらをつなぐループ



Copyright (C) Digital Media Professionals Inc. All Rights Reserved.

こちらは実際のユースケース、どのように使われるかを記載しています。固定の「目」と記載していますが、監視カメラなどがすでに工場、倉庫、店頭など様々なところに設置されています。また右側の動く「目」として、ドローンや AMR（自律搬送ロボット）なども今たくさん使われています。

これらのデバイスは大量の画像データを生み出していますが、現状ではこれらの画像データを常にクラウドに送り、クラウドで処理する必要があります。ここに Di1 を搭載することによって、デバイス上で得た画像をその場で即座に認識・理解し、様々な判断をして行動につなげることが可能になります。これによって処理スピードが非常に速くなるほか、データを送らなくてよいため通信コストや電力も減り、プライバシーの問題も解決できるなど様々なメリットがあり、非常に高度なフィジカル AI のシステムができるということです。

02 Physical AIの実装

エッジAI半導体「Di1」：エコシステム構築のフェーズへ

国内外パートナーとの実装・検証を通じて、Di1搭載製品の製品化を加速



DMP

開発キットSOM

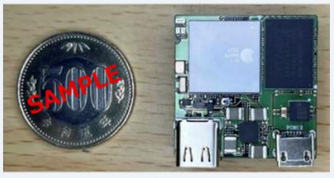
開発期間の短縮に貢献



iCatch Technology

OSM Size-L準拠SOM

BGAにより基板に直接実装が可能



T2 Laboratory

コインサイズSOM

超小型モジュールなど先端SOM設計サービスを提供

※SOM（System on Module）：プロセッサ・メモリなどを1枚に搭載し、機器にそのまま組み込める小型モジュール

Copyright (C) Digital Media Professionals Inc. All Rights Reserved.

この Di1 を広げていくうえで非常に重要なのがエコシステムです。お客様が迅速に製品を開発して市場に送

り出すためには、デバイスだけでなく、それを取り巻く様々な要素、例えばソフトウェアの開発、適切なセンサーの選択、ボードや筐体の設計などが必要になります。これを当社だけでなく、エコシステムとしてパートナーの皆様と一緒になってお客様を支援していくことが非常に重要です。
ここではその中からボードの例を挙げています。お客様では例外なくボードの開発が必要になりますが、DMP は開発キット・開発用の SOM（System on Module）を供給しています。また、iCatch Technology 社は OSM 規格のモジュールを提供しています。このモジュールはコネクタ等を介さずにそのまま基板上に実装することができ、非常に信頼性の高いシステムがつくれます。さらに、当社のパートナーである T2 Laboratory 様は、3 センチ角のコインサイズの SOM といった超小型のモジュールを開発する技術を持っておられ、小型システムを開発されるお客様に向けたデザインサービスを提供しています。

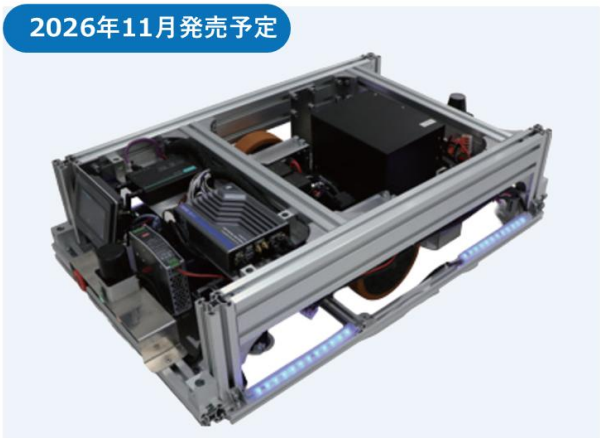


次にフィジカル AI の実装についてです。東京流通センター内にある当社のフィジカル AI の実装拠点、東京ロボティクス・イノベーションセンターが、7 月 24 日にメディア 12 社を招いて開所式を開催し、フィジカル AI の実装拠点として稼働を開始しています。
TRIC という略称で呼んでいますが、こちらには DMP の歴史や技術、そして当社の製品・サービスが一堂に展示されています。お客様に DMP を見ていただくとともに、このスペースの中でお客様と様々な実装の実験・検証やトレーニングを行う場として活用してまいります。

02 Physical AIの実装 — 新製品

DMP RX-D400

AMR開発を強力に支援する評価用キット



01 オールインワンコンポーネント

02 高精度なSLAM性能

03 高い拡張性と柔軟性

04 豊富な周辺機器とオプション

05 強力な開発支援

06 優れたコストパフォーマンス

Copyright (C) Digital Media Professionals Inc. All Rights Reserved.

また、この分野に関連して、当社の新規事業である FA 事業においても、AMR の評価用キット（開発キット）を新しく発売する予定です。これは AMR（自律搬送ロボット）を開発されるお客様に向けて、必要なコンポーネントや筐体の設計データ、周辺機器オプション、そして非常に精度の高い SLAM という自己位置推定を用いた自律走行用ソフトウェアなどをオールインワンのパッケージとして提供することで、お客様の AMR の開発を支援するものです。今月、11 月に発売を開始する予定です。

03 Dual Useへの展開

DMP、Dual Use市場へ参入

Dual Useドローン世界3位のideaForgeと双方向で協業 — Di1は世界へ、ideaForge機体は日本へ



※1 2024年12月時点、DIIの調査による（ideaForge社資料より）
※2 2025年12月時点（同）
※3 国内への機体導入は計画段階であり、時期・内容は未定です

Copyright (C) Digital Media Professionals Inc. All Rights Reserved.

次に、今後の取り組みとして、デュアルユース市場への参入があります。デュアルユースドローンで世界第３位の ideaForge 社というインドの会社と、双方向で協業しています。

まず、ideaForge 社が当社の Di1 を搭載した新しいドローンを開発しています。ペイロードと呼ばれるドローンの下に取り付けるカメラに Di1 が入っており、それと障害物検出用のカメラなどを搭載した新しいドローンで

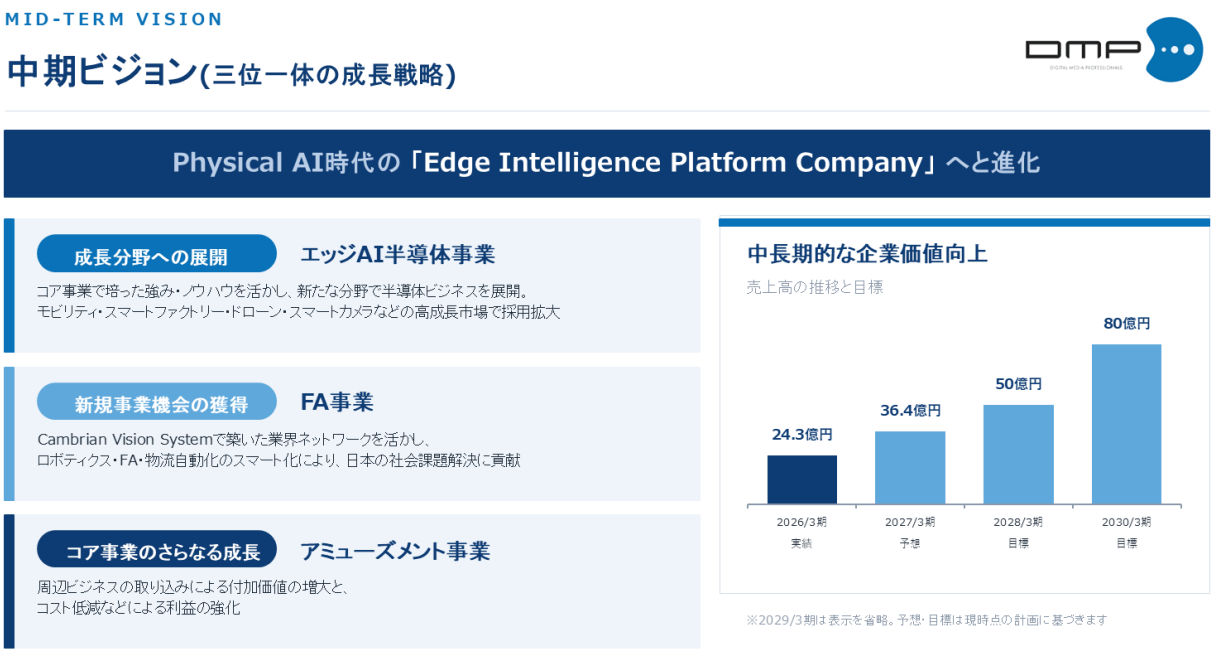
す。これを ideaForge 社のチャネルを通じて全世界に販売していきます。ideaForge 社はすでに南米、北米、ヨーロッパ、アフリカ、アジアでビジネスを展開しており、そこに Di1 を搭載したドローンが投入されていきます。

また同時に、ideaForge 社のドローンを DMP が日本の市場に投入、展開することを現在検討している段階です。こうした双方向の協業により、実績のあるデュアルユースのドローンメーカーと組んで、当社のデュアルユースのビジネスを日本国内においても展開していくことを考えています。



それから 10 月 21 日に、この ideaForge 社と、同じくインドの有力なカメラメーカーである Sparsh CCTV 社の 2 社のトップを招いて、東京で DMP 主催のフィジカル AI セミナーを開催しました。Sparsh CCTV 社も現在、DMP の Di1 を搭載したカメラを開発しており、来年の量産に向けて開発を進めています。

当日はたくさんのお客様に来ていただき、この 2 社から、Di1 を使ったフィジカル AI の今後のシステム開発や、将来のフィジカル AI の姿についてお話しいただきました。同時に、防衛分野に知見をお持ちの方々を含め、国内の業界関係者の方々との関係を築くことができました。



最後になりますが、当社の中期ビジョンとして、三位一体の成長戦略により、フィジカル AI 時代の「Edge Intelligence Platform Company」へと進化してまいります。

1 つ目は成長分野への展開として、エッジ AI 半導体事業です。これまで培ってきた GPU・AI のコア事業の強みとノウハウを活かし、新しい分野で半導体ビジネスをさらに拡大して、モビリティ、スマートファクトリー、ドローン、スマートカメラといった市場で採用を広げていきます。

2 つ目は新規事業機会の獲得として、昨年から参入した FA 事業です。これまで Cambrian というビジョンシステムを販売する中で築いたネットワークも活かし、ロボティクス、FA、物流の自動化やスマート化により、日本の社会課題の解決に貢献してまいります。

3 つ目は、これらを支えるコア事業であるアミューズメント事業です。周辺ビジネスの取り込みによる付加価値の増大などにより、さらに成長させてまいります。

これらにより、2028 年 3 月期に売上高 50 億円、2030 年 3 月期に 80 億円を目指し、中長期的な企業価値の向上を図ってまいります。以上でございます。ご清聴ありがとうございました。

[質疑応答]

Q1：Di1 について、上期において開発キットや実証評価から量産・継続受注へ移行した案件はありましたか。開示できる範囲で、件数や分野を教えてください。

A1：Di1 は量産体制を構築済みです。上期は開発キット等を国内外のお客様に出荷しました。現在、国内外の複数のお客様において Di1 搭載製品の開発が進んでおり、当社も開発・量産の各段階に向けた体制の増強を進めています。量産・継続受注への移行状況については、お客様の製品開発や製品発表のスケジュールに関わるため、個別の件数や分野の開示は控えさせていただきます。当社は引き続き、お客様の製品化・量産化の支援に努めてまいります。

Q2：インドの Sparsh CCTV 社との 4 月の基本合意で示された「約 5 ヶ月を目安に量産を視野に入れた試作機を準備する」という計画は、どこまで進んでいるのでしょうか。試作の準備状況、性能評価の段階、量産化に向けた次のステップを教えてください。
A2：Sparsh CCTV 社とは 2026 年 4 月に基本合意書を締結しています。この中で「5 ヶ月を目安に」という記載がありましたので、5 ヶ月が経過しようとしている中でのご質問と理解しています。この上期には、Di1 を搭載した次世代 AI カメラの開発に当社のエンジニアが積極的に参画しています。東京・インドを拠点とする当社のメンバーが現地を訪れたり、リモートでディスカッションしたりしながら、製品化に向けた設計・評価を進めています。10 月 21 日に当社が開催したセミナーに登壇された Sparsh CCTV 社からも、開発が順調に進んでいること、当社の開発支援によって開発期間の短縮が図られていることについて、大変高い評価をいただいています。ほぼオンスケジュールと言ってよい状況で案件は進んでいると考えていますが、具体的なスケジュールについては、先ほどと同様にパートナー企業の製品開発に関わるため、詳細は控えさせていただきます。

Q3：ideaForge 社との協業では、Di1 搭載ドローンの統合評価や、日本市場でのデモ・顧客開拓は進んでいますか。また、10 月 21 日のイベントで示された地形の空間マッピング分野での日本参入の検討は、デモや顧客開拓の面でどこまで進んでいますか。
A3：ideaForge 社とは、Di1 を搭載した次世代 AI ドローンの開発を上期においても進めています。Sparsh CCTV 社と同様に、ideaForge 社からも、Di1 の技術によって解決できる課題がたくさんある可能性を感じているという旨を、先日のセミナーでご発言いただいています。
ideaForge 社については、Di1 を搭載する製品の開発と同時に、同社のドローンを日本で販売する Go-To-Market 戦略を当社が支援する取り組みを進めています。いずれも詳細を申し上げることは難しいのですが、日本での販売については、当社にとっても新しい分野ではあるものの、当社の製品がユースケースとして使われるドローンのビジネスドメインがどのようなものかが協業によって具体的につかめてきていますので、かなり積極的に進めています。具体的な時期や内容については、発表できるタイミングまでお待ちいただければと思います。

Q4：ロボティクス・セーフティ分野の伸びは、上期も続いているのでしょうか。
A4：ロボティクス・セーフティ分野の売上高は、先ほどお話ししたとおり伸長しており、第 1 四半期と第 2 四半期を比べても第 2 四半期の方が売上は多くなっています。Di1 と関係するビジネスや、受託開発によるシステム開発・ソフト開発といったシナジーもありますので、引き続き注力してまいりたいと考えています。
また、昨年 4 月から始めた FA 事業は、昨年の上期は売上が非常に少なかったのですが、今年度は第 1 四半期から第 2 四半期にかけて伸ばすことができています。通期でも意欲的な目標を持って取り組んでおり、積極的に拡大させていきます。FA 事業は新たなお客様との接点となり得るビジネスですので、そうした接点から、エッジ AI 半導体の案件や、プロフェッショナルサービスの案件、IP ライセンスの案件への広がりが出てくると考えています。こちらも積極的に進めてまいります。

Q5：売上高など通期予想は維持される予定ですか。判断材料となる点を教えてください。
A5：上期だけを見ると、売上高の目標に対する進捗率が 25%を下回っていることから、ご心配いただいて

のご質問かと思います。今期の当初の計画を立てる段階から、もともと下期偏重の計画を立てていました。これは、エッジ AI 半導体 Di1 事業の立ち上がりから売上計上までには相応の時間を要するという判断と、アミューズメント分野の周辺ビジネスについても第 3 四半期以降の売上計上を計画していたことによるものです。先ほどご説明したとおり、ロボティクス・セーフティ分野も順調に拡大していますので、5 月 15 日に公表した売上高 36 億 4000 万円の計画に向けて邁進していきます。

Q6：大株主かつ資本業務提携先である株式会社レスターについて、EDINET 上、短期間での大量売却・買戻しや、変更報告書が 2026 年 4 月 10 日にまとめて提出されています。経営陣としてこれらの事実を把握していらっしゃいますか。
A6：株式会社レスター様の大量保有報告書および変更報告書については、EDINET を通じて開示されている情報として当社でも確認しています。ご指摘の期間における売却・買戻しの経緯および変更報告書の提出時期についても、開示情報の範囲内で把握しています。これらは金融商品取引法に基づき、各株主様がご自身の判断と責任において提出されるものですので、個別の売買動向や提出時期の当否については、第一義的には提出者であるレスター様においてご説明される事項であると認識しています。

Q7：レスター社の DMP 株式の保有目的が「業務資本提携に基づく業務上の関係強化のため」とされながら、実質的な売買増減が繰り返されている現状について、資本業務提携先として信頼関係に影響はないとお考えですか。
A7：結論から申し上げますと、信頼関係に影響はないと考えています。レスター様とは 2014 年 5 月の資本業務提携以来、当社製品の主要販売代理店として継続的に協業関係を築いており、前期の当社売上高の 80%を占める重要な事業パートナーです。資本業務提携の実効性は、短期的な保有比率の変動ではなく、取引実績や協業内容の実態を踏まえて評価すべきものと考えており、この点からも信頼関係に影響はないと考えています。

Q8：一般株主への情報透明性と提携関係の健全化を図るため、レスター社に対して事情確認や協議を行う考えはありますか。
A8：ご懸念については、貴重なご意見として受け止めたいと思います。本件については、株主の皆様への説明の必要性を踏まえ、本日のご質問にお答えしているように、可能な限りご説明を続けていきたいと考えています。

Q9：アミューズメント分野の進捗に遅れが生じていますが、挽回できるのでしょうか。現時点で挽回できなければ、下方修正の必要があると考えますが、いかがでしょうか。
A9：業績予想の開示のルールがありますので、それを念頭に、当社としても毎月、進捗と売上の見込みについて議論しています。アミューズメント分野についても下期の案件を精査して議論しており、現状において見込みを変える必要はないとの判断に至っています。

Q10：競合他社の業績が好調な中、DMP の主力であるアミューズメント領域の売上が伸びていない点が気になります。現状では売上予想の達成は厳しいように感じますが、下方修正はされないのでしょうか。

A10：現時点において下方修正は行っていません。競合他社の業績が好調ということもありますが、当社としても今期はアミューズメント分野も前年に比べて成長を図る計画を進めている途中ですので、その達成に向けて進めてまいります。

Q11：決算説明会資料 13 ページに「Di1 の初回量産が 2027 年 1～3 月」とありますが、顧客製品開発進行中の 6 社のうち何社がこの時期の量産対象でしょうか。すでに設計採用や発注が確定している案件はあるのでしょうか。
A11：6 社と申し上げましたが、1 月から 3 月というのは、その中で一番早いお客様の量産が立ち上がる時期で、少なくとも 1 社です。その他のお客様はセカンドクォーターからの会社が多いのですが、だいたいファーストクォーター、セカンドクォーターに数社が量産をスタートしてくると考えています。これらのお客様はすでにサンプルの手配、それから量産のチップの手配を進めていますので、そういった意味では受注に近い段階にあると言って差し支えないかと思います。

Q12：量産化が来年 1 月から開始されるとおっしゃいましたが、売上・利益はどのくらいになるのでしょうか。
A12：業績に関わるご質問ですので、私からお答えします。2027 年 3 月期の期初の計画において、Di1 関連事業の売上は、5 月の説明会でも申し上げたとおり一定程度見込んでいました。この計画との比較のお話になるかと思いますが、現状においては、先ほど下方修正のご質問もありましたが、業績を上方修正する判断はしていません。

Q13：ideaForge 社のドローン機体の日本展開について、DMP での体制を構築されてからということですが、現状どのような状況でしょうか。国内には競合他社もおり、競合に勝つにはスピード感を持った展開が必要になるかと思います。
A13：おっしゃるとおり、ドローンを市場に導入するというのは、単純に機体を持ってくればいいという話ではなく、例えば試験場の確保、パイロットの確保、機体整備など様々な要素が絡んでいます。当社は現在、国内で実際にドローンの実績のある会社様と協業の話を進めており、ideaForge 社のドローンを国内で導入することをパートナー様とともに検討しています。

Q14：ideaForge 社のドローンの優位性を教えてください。また、日本展開する場合は防衛用途でも検討されるかと思いますが、参入の余地はあるのでしょうか。
A14：ideaForge 社は、先ほど申し上げたとおり、デュアルユースという分野において世界第 3 位の実績があります。これはインドだけでなく海外も含めてのもので、例えば北米には防衛分野に入るための非常に厳しい規格である NDAA がありますが、ideaForge 社はこちらにも対応しています。
強みは、非常に過酷な環境での飛行実績が豊富なことです。約 100 万回の飛行実績があり、現在でもおおむね 2 分から 3 分に 1 機、ideaForge 社のドローンが飛び立っている状況です。例えば標高数千メートルといった非常に高い場所から離陸するといった難易度の高い環境でも実績があります。また防衛用途では、ジャミングにより、例えば GPS の信号が得られなかったり通信が途絶えたりといったことが起こり得る中でも使えなければなりませんが、そうした開発も進んでいます。
このように、特に過酷な場所や飛行時間など様々な環境条件の中で動いてきた実績が豊富にあり、インド

国内の防衛分野でもかなりの数の実績がありますので、非常に信頼できるパートナーです。

Q15：Di1 の事業進捗について、量産を前提とした顧客は現時点で 6 社とのことですが、開発を検討している潜在顧客は何社くらいあるのでしょうか。
A15：先ほどの説明が少し足りなかったかと思いますが、実際に 6 社のお客様が、量産を前提とした開発を具体的に進めています。その中で日本は 1 社と申し上げましたが、日本国内にも現在評価しているお客様がたくさんいらっしゃいます。日本は他の国に比べると開発に時間がかかるという状況が見えてきていますが、こちらのお客様がこれから開発に着手していくと考えています。具体的な数を申し上げるのは難しいのですが、実際に開発に取りかかっているお客様の数よりはるかに多くのお客様がいらっしゃいます。ただ、当社にとって重要なのはどのくらいの数量が出るかということで、大きなお客様という観点で見ると、数社の有力なお客様がいると見ています。

Q16：ロボティクス分野・FA 分野について、売上・利益の伸びがなかなか鈍いと感じています。フィジカル AI 関連の会社は国内にもありますが、あまり伸びておらず、DMP にはしっかり成長してほしいので不安を感じています。売上の伸びが鈍い理由を知りたいです。
A16：フィジカル AI 関連と言いましても、実際の市場の規模や成長という観点では、これからというのが現状だと考えています。その中で当社は、半導体、ソフトウェア、そして最終的な製品までを組み合わせたビジネスを行っていますので、そういった意味では国内の他社に比べても優位であると考えています。
当社のフィジカル AI 関連の中には、Di1 の分野と FA 製品の分野がありますが、FA の分野は当社が期待していた以上に成長しています。数字で申し上げると、昨年 1 年間の売上の約 2.5 倍から 3 倍の受注を、今年は 11 月の時点ですでに達成しており、期待以上に伸びているとともに、これからも大きな成長が期待できると考えています。この FA と Di1 半導体を組み合わせて取り組むことで、今後この分野を伸ばしていきたいと考えています。

Q17：Di1 について、米国での展開は加速できないのでしょうか。今後エッジ AI の重要性は増していくと思いますし、DMP は性能面において優位性があると期待しています。
A17：米国に関しては、すでに申し上げたとおり、海外ではアジア、インドや台湾のビジネスが進捗していますが、米国についても今年市場調査を行い、それなりに需要があることは確認できています。あとは当社のリソースとの兼ね合いもありますので、その辺りを見ながら取り組んでいくことが、当社が今後やるべきことの一つと考えています。実際には、1 社、カメラモジュールメーカーさんがすでに Di1 を使ったカメラモジュールの開発を行っており、取り組んでいないわけではなく、すでに進んでいます。私の希望としては、ここにもう少し本腰を入れたいと考えており、そこは今後の大きな課題と考えています。

■本書き起こしに含まれる将来の見通しに関する記述は、説明会開催時点において当社が入手している情報に基づき判断したものであり、マクロ環境や当社の関連する業界動向等により変動することがあります。従いまして、実際の業績等が、将来の見通しに関する記述と異なる可能性があることをご了承ください。
■また、本書き起こしは、当社をご理解いただくための情報提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券への投資を勧誘するものではありません。

以上